

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-014

## 龙迅半导体（合肥）股份有限公司

# 关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告 暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### ● 重要内容提示：

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露了《龙迅股份关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2024年行动方案的实施进展及评估情况”和“2025年主要措施”报告如下：

### 一、重视股东回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期可持续的价值。上市以来，公司积极实施现金分红、资本公积转增、回购及控股股东增持，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

2024年上半年，公司实施完成了2023年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.0255元（含税），合计派发现金红利96,471,274.35元（含税），2023

年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为93.94%。同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，合计转增33,015,728股，转增后公司总股本由69,264,862股增加至102,280,590股。

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。回购股份的价格不超过人民币88.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司进行2023年年度权益分派，上述回购股份价格上限于2024年6月3日由不超过人民币88.00元/股（含）调整为不超过人民币58.65元/股（含）。截至2024年9月30日，公司完成回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份867,474股，占公司目前总股本102,280,590股的比例为0.85%，回购成交的最高价为86.48元/股，最低价为44.06元/股，支付的资金总额为人民币59,201,883.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理FENG CHEN先生于2024年7月期间在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份92,167股，占公司总股本的0.09%，合计增持金额为人民币489.95万元（不含交易费用）。

2025年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。利润分配方面，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），合计拟派发现金红利70,989,181.20元（含税），本年度公司现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.16%；同时，拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，合计拟转增30,423,935股，转增后公司总股本将由102,280,590股增加至132,704,525股（最终以中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

## 二、持续自主创新，持续构建核心竞争力

2024 年，公司持续加大在各产品条线的研发投入，进一步提升研发平台硬件设施水平，壮大研发团队，优化组织架构，为产品升级及新品开发提供充分保障，全年累计投入 9,996.86 万元，较上年同期增加 34.14%，占营业收入比重为 21.45%。

公司注重跨应用领域的技术融合，注重与世界知名公司的技术交流，精准把握行业应用需求，进一步丰富产品矩阵，产品迭代及新品开发的针对性和前瞻性更强。公司陆续推出高版本 DP1.4/Type-C Multimedia HUB 系列芯片，最高支持 4K@144Hz 分辨率、支持多路异显功能、MIPI DPHY/CPHY 转 DP1.4/HDMI2.1 芯片，支持图像帧率转换和缩放功能的 eDP 转 MIPI，多通道高速数据模拟切换芯片等多款新产品。新的产品不仅支持更高的规格，更高的传输速率，还能向下兼容过往的协议版本，提高产品的兼容性，以期为客户带来更加优质和多样化的选择。公司与 PCIe 协议和 USB 协议相关的研发项目均在有序推进中。

汽车电子作为公司重要的业务拓展方向，公司持续加大在该领域的研发投入和新品布局。凭借良好的兼容性和稳定性，公司持续新增汽车用户并扩大车系覆盖率。2024 年，公司桥接类的芯片在车载抬头显示和车载信息娱乐等系统的市场份额明显提升；解决 ADAS SOC 模组与座舱域控 SOC 间视频信号桥接的方案，在油电混动车和燃油车等车型上已开始批量出货。针对汽车市场对于视频长距离传输和超高清视频显示需求开发的车载 SerDes 芯片组进入全面市场推广，其中，电动两轮车仪表盘、工业焊接 3D 摄像机等领域已逐步量产；车内行车监控、农业无人智驾小车等领域正处于原型机验证测试阶段。

为增强公司在车载娱乐系统、座舱显示和 ADAS 解决方案领域的市场优势，2024 年底，公司成立了汽车芯片和系统解决方案事业部。车载事业部将专注于车载娱乐系统、座舱显示、HUD、ADAS 视频采集和传输 SERDES、多路显示传输 SERDES、车规级面板和驱动、音频传输 SERDES 以及麦克风和扬声器等领域的车规级芯片及解决方案。

2025年，公司将进一步进行能力提升和建设。通过加强对高水平拔尖人才、科技骨干的引进和培养，优化研发队伍人员结构；通过改善软硬件条件，使公司有能力和加强科技攻关力度；通过对现有技术进行改良和提升，提高原有产品工艺制程；通过研发的逐渐深入，逐步转向附加值更高的市场领域。公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

### 三、优化运营管理，提高经营质量

2024年，公司持续优化供应链系统，完善现有的供应商选择和管理流程，强化与供应商建立更为紧密的合作关系，从而提升公司质量、交付能力；为确保供应链的稳定性和安全性，持续建设国内国外代工双循环供应体系；通过引进新供应商和对现有供应商价格谈判等措施，有效控制采购成本。新工艺方面，公司加大了对新工艺、新材料、新封装形式的研究与应用。力求通过采用新的半导体技术和先进的制造工艺，开拓更高规格的产品，使得产品在数据传输速度、功耗管理等方面获得更为卓越的表现。

2024年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》。计划亦设定了营业收入增长率、毛利率的公司层面业绩考核要求，也设定了个人层面的业绩考核要求，锚定公司成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标绑定管理层和员工的利益与公司发展目标共同达成，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2025年公司将加强产品质量控制力度和产品认证速度，确保向客户提供更为性能优越、可靠性高的芯片方案，进一步提高客户满意度；进一步建设车规级产品质量管控体系，为公司全面进入车载市场奠定基础。完善管理流程、推进信息化建设，

满足更多知名客户的审厂要求；加强供应链保证能力，匹配公司的快速增长规模，降本增效，做好成本控制；进一步落实国际化战略，持续建设国内国外代工双循环供应体系，加速新加坡子公司的全面运营。以公司业务规划为导向，优化组织架构，积极探索国际化人才战略；切实关注员工身心健康、安全和满意度，进一步为员工提供舒适、优化工作环境；不断探索激励机制，完善薪酬体系，促进企业和员工的共同成长。

#### 四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

2024年，为进一步完善公司治理结构，建立健全管理机制，公司对《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》等14项内控制度进行修订；同时，为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，公司特制定了《会计师事务所选聘制度》，并颁布实施。2024年12月，公司顺利完成第四届董事会、监事会换届选举工作，持续优化公司治理结构。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范。2024年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下的培训15次，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

2025年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

强化“关键少数”责任方面，公司将继续与公司大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监

高的互动沟通,及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例,多维度提升公司治理能力切实推动公司高质量发展,维护全体股东的利益。

## **五、高质量信息披露,积极传递公司投资价值**

公司高度重视信息披露工作,始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露相关制度,积极履行各项信息披露义务,持续提升公司信息披露的质量和透明度。2024年,公司累计发布定期报告4份,临时公告85份。公司坚持从投资者需求出发,持续优化定期报告编制披露方式,从框架、内容、形式等多方面进行拓展,以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。2024年,公司举办了2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度和2024年第三季度业绩说明会,结合文字互动、图文展示等形式,全方位向投资者展示公司经营情况。年度内,组织参与投资者线上线下路演交流活动14场,披露投资者关系活动记录表10份;e互动平台回复投资者提问50次,回复率100%。

2025年,公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露相关制度,积极履行各项信息披露义务,持续提升公司信息披露的质量和透明度。继续强化投资者关系管理,树立科学的市值观,加强与投资者互动交流,重视公司资本市场表现,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配,不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感,提高公司的市场形象和品牌价值。组织、参与投资者线上线下路演交流活动不少于20次,让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况,增进投资者对公司的信任与支持,打造高效透明的沟通平台。

## **六、持续评估完善行动方案,维护公司市场形象**

2024年度,通过实施“提质增效重回报”专项行动方案,推动了公司高质量发展,切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措,在2024年度方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者,切实履行上市公司责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年2月28日